

SMT256EP 可焊接型黏合劑 產品資料表

優異的導電性
消除接觸電阻
適用於高溫環境

簡介

SMT256EP 可焊接黏合劑是一種自流平、自焊接黏合劑，專為高溫無鉛應用而設計。與導電膠（銀膠）相比，SMT256EP 可焊黏合劑具有更高的穩定電導率和導熱率、卓越的可靠性以及易於返修的特性。與傳統焊料相比，SMT256EP 可焊黏合劑消除了焊接過程中的氣體逸出、助焊劑殘留問題和焊料溢出。在回流焊接過程中，焊點封裝黏合劑可去除金屬氧化物，並封裝單一焊點，從而增強焊點強度，克服底部填充的一些缺點（例如高於玻璃化轉變溫度 (T_g) 的高熱膨脹係數 (CTE) 和複雜的製程控制)。與使用焊膏相比，其跌落測試性能提高了兩個數量級。聚合物網絡可以使用丁酮 (MEK) 或加熱來去除。

物理特性

产品名称	SMT256EP 可焊接黏合劑
合金填料	可焊金属粉末 (T4)
树脂体系	环氧树脂
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	3.5 – 4.5 g/cc
粘度 (Brookfield, 0.5 rpm)	80 – 100 kcp
固化材料特性	
拉伸強度 (MPa)	56
C.T. E (ASTM E 831), PPM/°C	23.5

楊氏模量(GPa)	26.3
导热系数(W/m·K)	60
電導率 (μΩ/cm)	10-30
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na ⁺	< 5 ppm
K ⁺	<5 ppm
F ⁻	< 5 ppm
Cl ⁻	< 10 ppm
表面绝缘电阻 (J-STD-004)	通过 (Pass)

回流焊接和固化

SMT256EP 與目前的 SMT 組裝流程以及所有類型的焊盤表面處理 (例如 Ni/Au、浸銀、OSP) 完全相容。它可在空氣或氮氣環境下，用於對流、傳導、紅外線或氣相焊接系統。從環境溫度升至峰值溫度的時間應為 4 至 5 分鐘，峰值溫度為 230°C 至 260°C。

儲存和保存期限

在低於 -20°C 的溫度下，將材料保存在密封的原包裝容器中，保存期限為 6 個月。超過此期限儲存可能會導致黏度升高。請避免潮濕、蒸發和異物污染。蒸發和污染會影響這些產品的加工性能。

安全信息

SMT256EP 是一種環保無毒材料。但是，建議在處理此材料時遵循一般的衛生操作規範。更多詳細信息，請參閱我們的安全資料表 (SDS)。

包裝規格

SMT256EP 膠合劑提供 10cc 和 30cc 包裝。根據客戶需求，還可提供其他包裝。請聯絡 YINCAE 以取得訂購資訊。